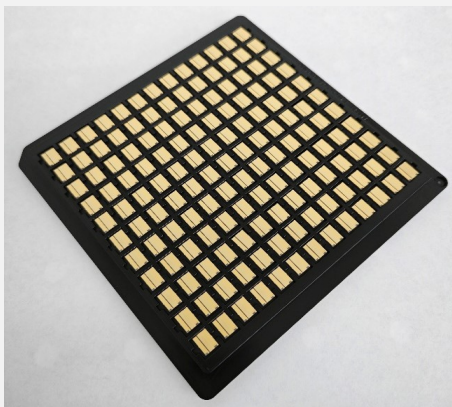




AIN 热沉

规格型号：DG-AIN-200-TM-AuSn-1112-A1



主要特性：

- 预制金锡焊料
- 高热导率
- CTE 匹配芯片材料

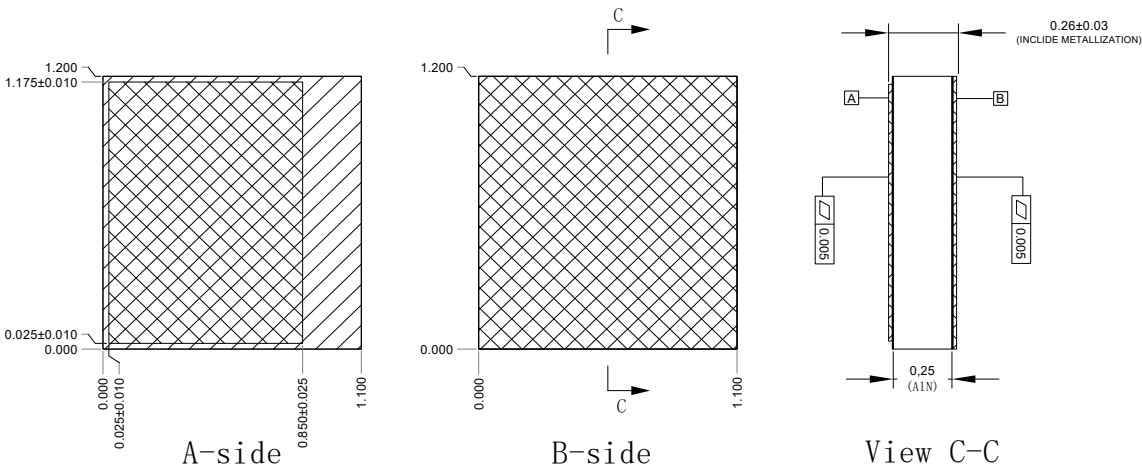


应用：

- 高功率激光芯片封装
- 科研与工程



详细图纸（mm）：



1. Metalization:

- A-side :Ti (0.1um min.)/Pt(0.2um min.)/Au(0.5um min.)
 :Ti (0.1um min.)/Pt(0.2um min.)/Au(0.5um min.)
+Pt (0.25±0.05um)/AuSn: Au75±5wt%(4.5±0.5um)/Au(0.04um)
- B-side :Ti (0.1um min.)/
+Pt (0.25±0.05um)/AuSn: Au75±5wt%(4.5±0.5um)/Au(0.04um)

2. Other tolerance: ±0.05mm

3. A/B Surface Roughness: Ra ≤ 0.1um

PARTS NAME	AIN Submount	DATE	2025-6-24
MODEL NAME	DG-AIN-200-TM-AuSn-1112-A1	SHEET	1/1
MATERIAL	AIN (≥200W/m²K)	DRAWN	
DIMENSION	1.10×1.20×0.26T	CHECKED	
UNIT	mm	APPROVED	

Dogain Optoelectronic Technology (Suzhou) Co., Ltd.

度亘保留所有权利。为保证产品的卓越品质和可靠性，产品规格和描述可能随时更新。了解具体产品详情，请与我们的销售代表联系获取。



度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司

地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城39栋

电话：0512-6179 0076，邮箱：sales@dogain.com，网址：www.dogain.com

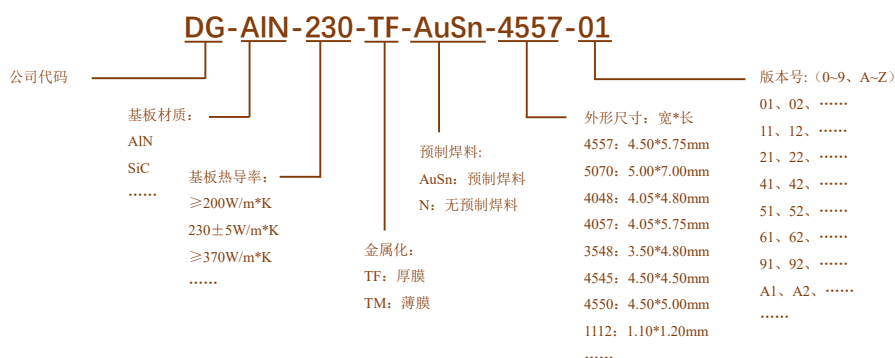


主要特征参数:

参数类别	单位	DG-AIN-200-TM-AuSn-1112-A1
长	mm	1.10±0.05
宽	mm	1.20±0.05
厚	mm	0.26±0.03
Ti 层厚度	um	0.1 min.
Pt 层厚度	um	0.2 min.
Au 层厚度	um	0.5 min.
Au 层粗糙度	um	≤0.1
AuSn 层厚度	um	4.5±0.5
AuSn 组分	wt%	75±5(Au)
平面度	um	≤5
基板材质	\	AlN 陶瓷
基板热导率	W/m*K	≥200
存储环境	\	真空包装或氮气柜
存储温度	°C	25±15
存储湿度	%	≤60
保质期	年	1

备注:

1. 其他尺寸规格可定制;
2. 标准包装方式: 蓝膜出货、芯片表面覆盖隔离膜, 6 寸子母环扩片, 真空密封包装。
3. 规格型号说明:



度亘保留所有权利。为保证产品的卓越品质和可靠性, 产品规格和描述可能随时更新。了解具体产品详情, 请与我们的销售代表联系获取。



度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司

地址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城39栋

电话: 0512-6179 0076, 邮箱: sales@dogain.com, 网址: www.dogain.com